2027年6月期　第1四半期
決算説明資料

連結決算概要および業績予想

株式会社 アルバック

2026年11月10日

目 次

1. 決算のポイント	3-5
2. 2027年6月期 第1四半期決算	6-14
3. 2027年6月期 業績予想	15-19
4. 補足資料	20-24

将来見通し等に関する記述についての注意事項

- **将来見通しについて**

  本資料に記載の業績見通しならびに将来予測は、現在入手可能な情報に基づき作成されたものです。世界経済情勢、半導体・電子部品・ディスプレイ・原材料などの市況、設備投資の動向、急速な技術革新への対応、為替レートの変動など様々な要因により、実際の業績・成果等はこれらの見通し・将来予測と大きく異なる可能性があることをご承知おきください。

- **数字の処理について**

  本資料に記載の数字・比率につきましては、単位未満四捨五入で処理しております。

- **品目別内訳の受注高・売上高について**

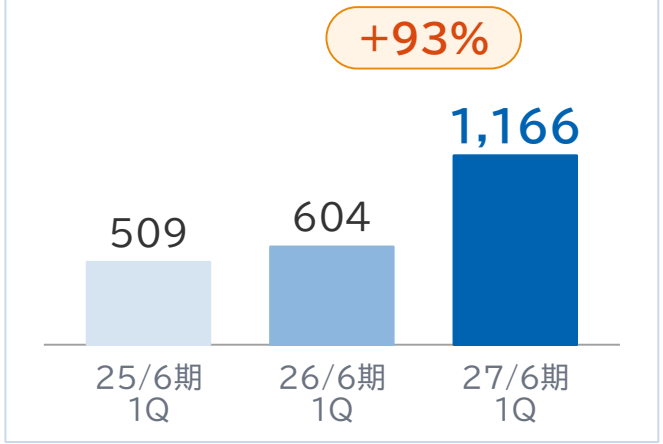
  品目別内訳の受注高および売上高は、管理会計ベースで試算しております。なお、カスタマーサービス分につきましては、それぞれの品目に配分して計上しております。

1 決算のポイント

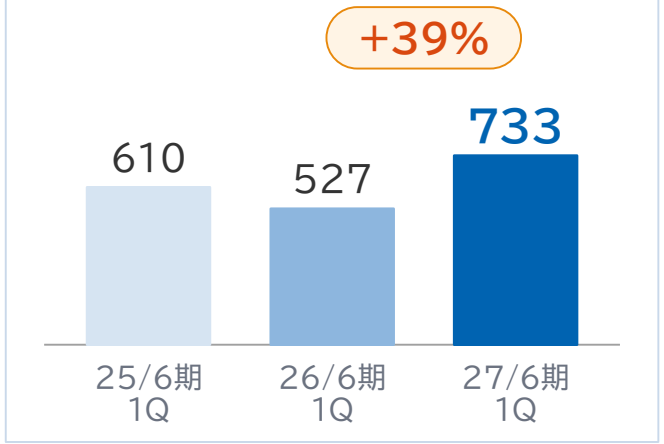
2027年6月期 第1四半期 決算概要

【単位:億円】

受注高



売上高



営業利益率

8.4%

(YoY +4.1pt)

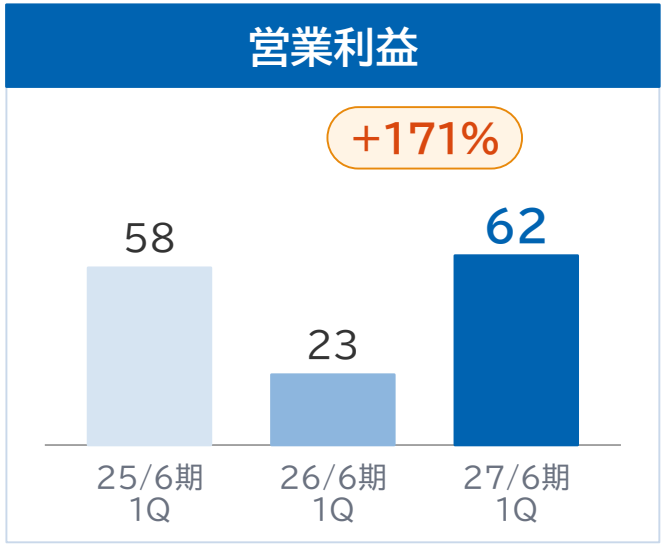
ROE※

8.8%

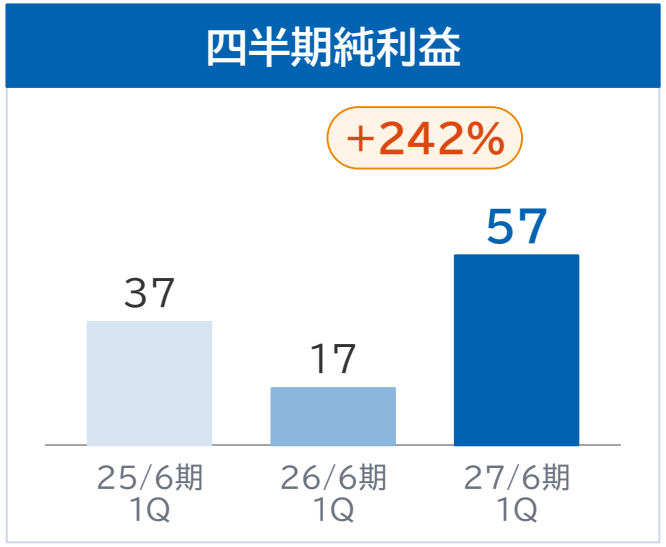
(YoY +2.2pt)

※年率換算ベース

営業利益



四半期純利益



フリーCF

230億円

(YoY +205億円)

Net D/Eレシオ

△0.24※

(YoY +0.02)

※現預金超過

自己資本比率

57.2%

(YoY △1.4pt)

Copyright© 2026, ULVAC, Inc. All rights reserved

2027年6月期 第1四半期 決算ポイント

2027年6月期 第1四半期決算 ビジネス好調

受注高 四半期ベース過去最高

1,166 億円

前年同期比 +562億円(+93%)

半導体電子・レアアース関連等が大きく牽引

売上高 大幅増収

733 億円

前年同期比 +206億円(+39%)

高水準の受注残高(26年6月期末:1,761億円)の寄与に加え、半導体関連の追加獲得案件等が牽引

営業利益 大幅増益

62 億円

前年同期比 +39億円(+171%)

半導体電子を中心とした増収に伴い売上総利益が拡大し、販管費等の増加を吸収して大幅な増益

2027年6月期 業績予想 上方修正

上期・通期

第1四半期の好調な進捗に加え、高水準の受注残高や、今後の堅調な事業環境の継続が見込まれるため受注高・売上高・各利益項目を上方修正

バリューアッププラン 着実に実行

成長戦略	付加価値の高い半導体電子・レアアース関連ビジネスが成長
生産改革	調達環境のタイト化に対し、当下期の平準化に向けた対策を推進中 工場内スペースの有効活用等によるキャパシティー増強を継続中
事業改革	事業ポートフォリオ最適化に向け、事業譲渡(連結子会社:3社)進展

Copyright© 2026, ULVAC, Inc. All rights reserved

2 2027年6月期第1四半期決算

業績概要

【単位:億円】

	2026/6期 1Q	2027/6期 1Q	前年同期比	
受注高	604	1,166	+562	+93%
売上高	527	733	+206	+39%
売上総利益	157	214	+58	+37%
率	29.7%	29.2%	-0.5pt	-
販管費	134	152	+18	+14%
営業利益	23	62	+39	+171%
率	4.3%	8.4%	+4.1pt	-
経常利益	25	90	+65	+262%
率	4.7%	12.3%	+7.5pt	-
親会社株主に帰属する四半期純利益	17	57	+40	+242%
率	3.2%	7.7%	+4.6pt	-

フリー・キャッシュ・フロー	25	230	+205
営業キャッシュ・フロー	58	160	+102
投資キャッシュ・フロー	-33	70	+103

Copyright© 2026, ULVAC, Inc. All rights reserved

バランスシート

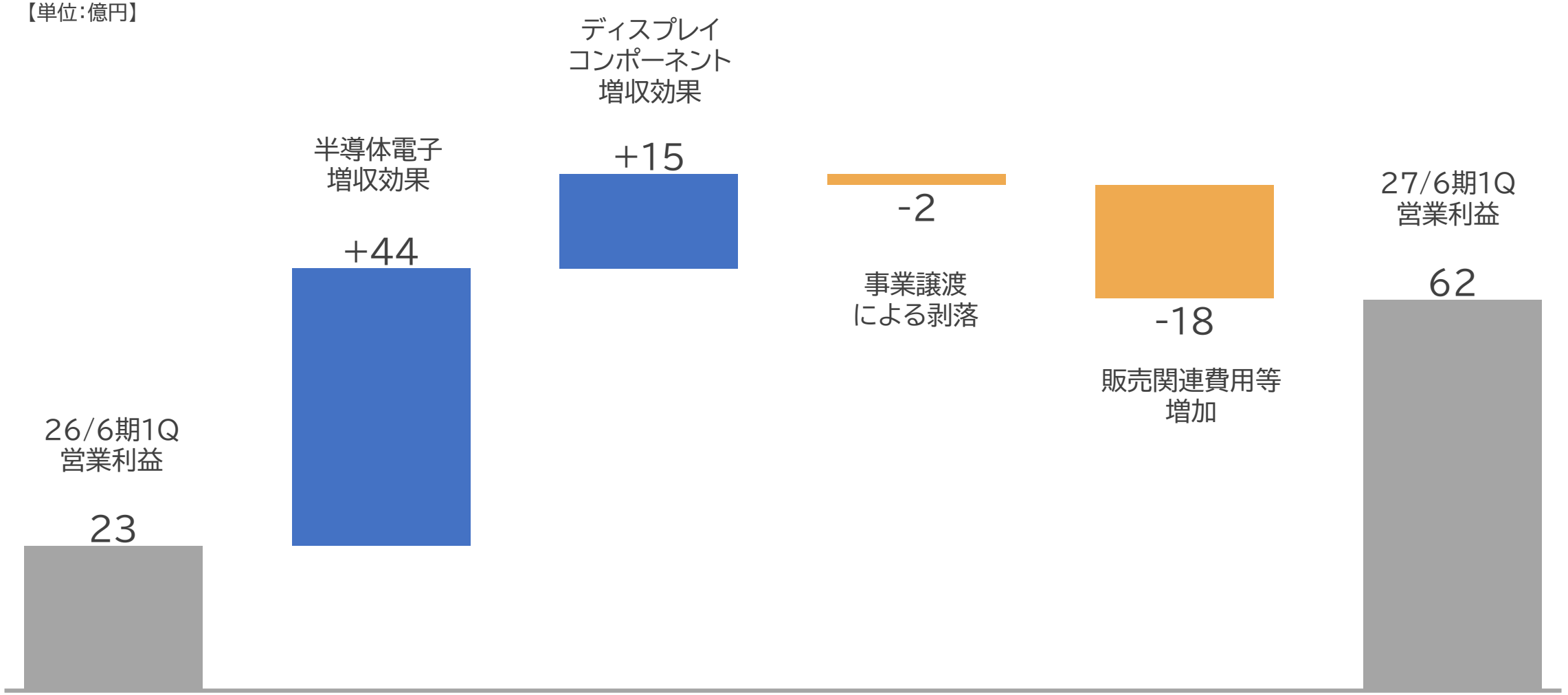
【単位:億円】

	2026/6期末	2027/6期 1Q末	増減額
現金・預金	1,050	1,021	-29
受取手形・売掛金	895	810	-85
棚卸資産	711	793	+82
その他の流動資産	365	403	+38
有形固定資産	804	814	+10
投資有価証券　他	317	351	+34
資産合計	**4,140**	**4,192**	**+51**
支払手形・買掛金	392	470	+79
有利子負債	442	438	-4
その他流動負債	739	728	-11
うち、契約負債	399	416	+17
その他固定負債	75	79	+3
純資産	2,492	2,476	-16
負債・資本合計	**4,140**	**4,192**	**+51**

Copyright© 2026, ULVAC, Inc. All rights reserved

営業利益増減分析

【単位：億円】



Copyright© 2026, ULVAC, Inc. All rights reserved

セグメント/品目実績

【単位:億円】

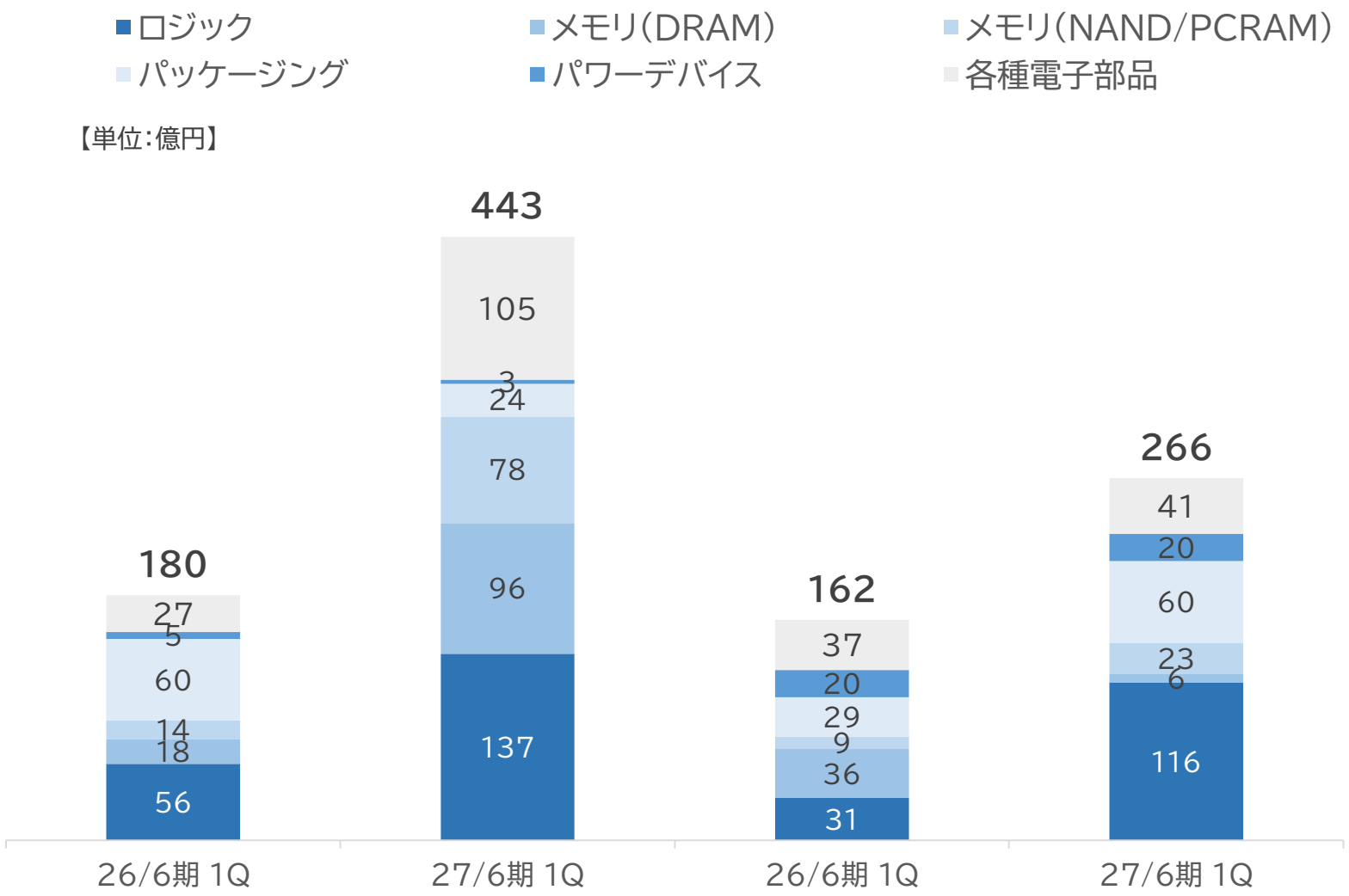
セグメント/品目	受注高			売上高		
	26/6期 1Q	27/6期 1Q	前年同期比	26/6期 1Q	27/6期 1Q	前年同期比
半導体及び電子部品製造装置	180	443	+263	162	266	+104
ディスプレイ・エネルギー関連製造装置	130	262	+132	111	164	+53
一般産業用装置	70	202	+132	45	73	+27
コンポーネント	78	123	+44	84	99	+15
真空機器事業	459	1,030	+571	402	602	+200
マテリアル	78	68	-10	63	69	+6
その他	68	68	+1	63	62	-1
真空応用事業	146	136	-9	126	131	+6
合計	604	1,166	+562	527	733	+206

Copyright© 2026, ULVAC, Inc. All rights reserved

半導体及び電子部品製造装置

受注高

売上高



POINT

受注高・売上高ともに大幅増

受注高は四半期ベースで過去最高を更新

◆ ロジック
中国向けMHM横展開により高水準受注継続

◆ メモリ(DRAM)
Top3メーカーに加え、台湾DRAMメーカーの設備投資が寄与

◆ メモリ(NAND/PCRAM)
中国PCRAMの立ち上げに伴う投資

◆ パッケージング
WLP向けアッシング装置が貢献。日・台向けにPLP用アッシング装置も受注

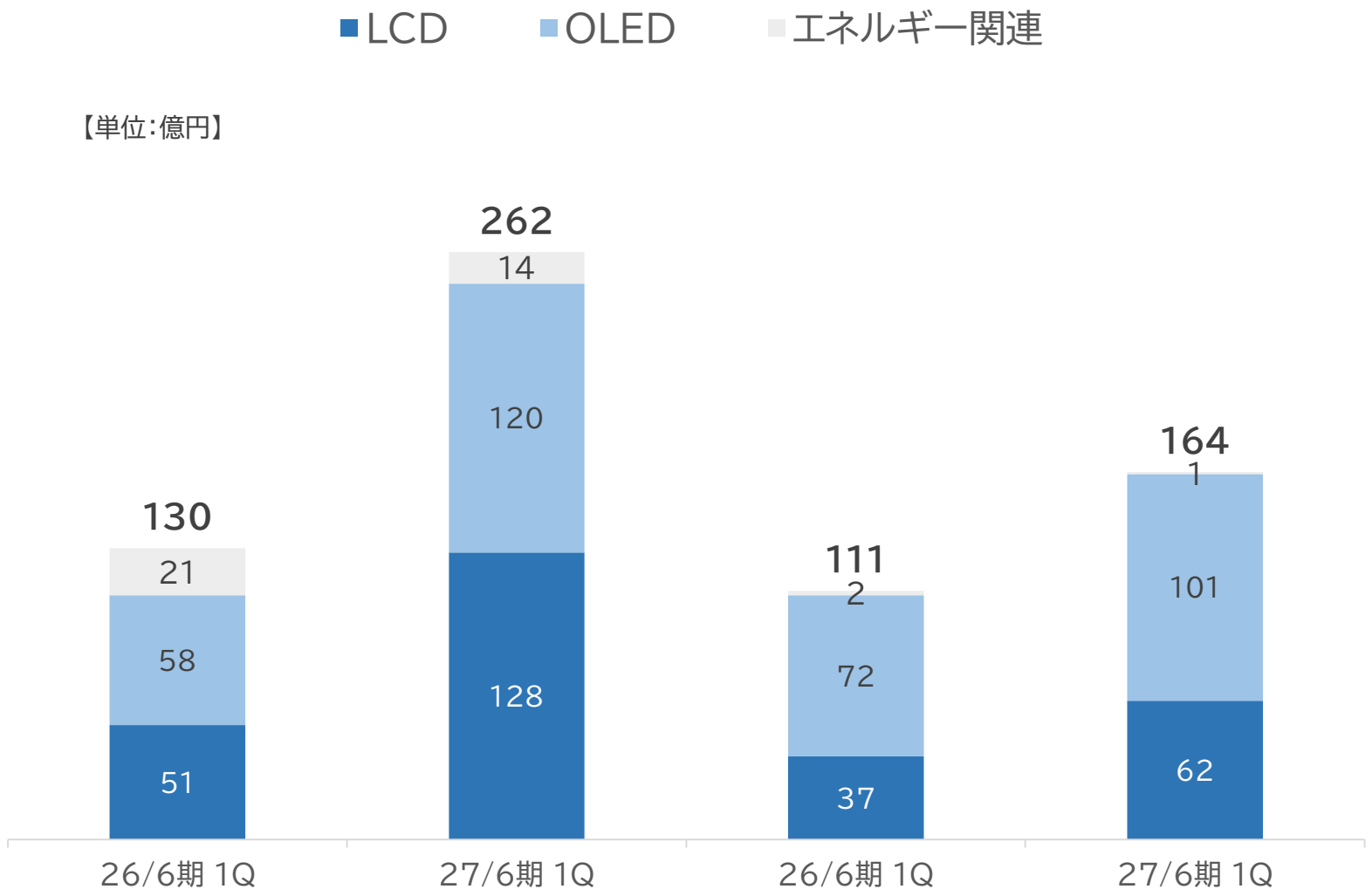
◆ 各種電子部品
データセンター向け光通信関連投資活発化

Copyright© 2026, ULVAC, Inc. All rights reserved

ディスプレイ・エネルギー関連製造装置

受注高

売上高



POINT

追加設備・改造案件寄与

◆ LCD
車載向けG8パネルの新規ライン投資に加え、追加設備および改造案件が寄与

◆ OLED
スマートフォン用フレキシブルパネル等の搭載拡大に伴う、追加設備・改造案件が寄与

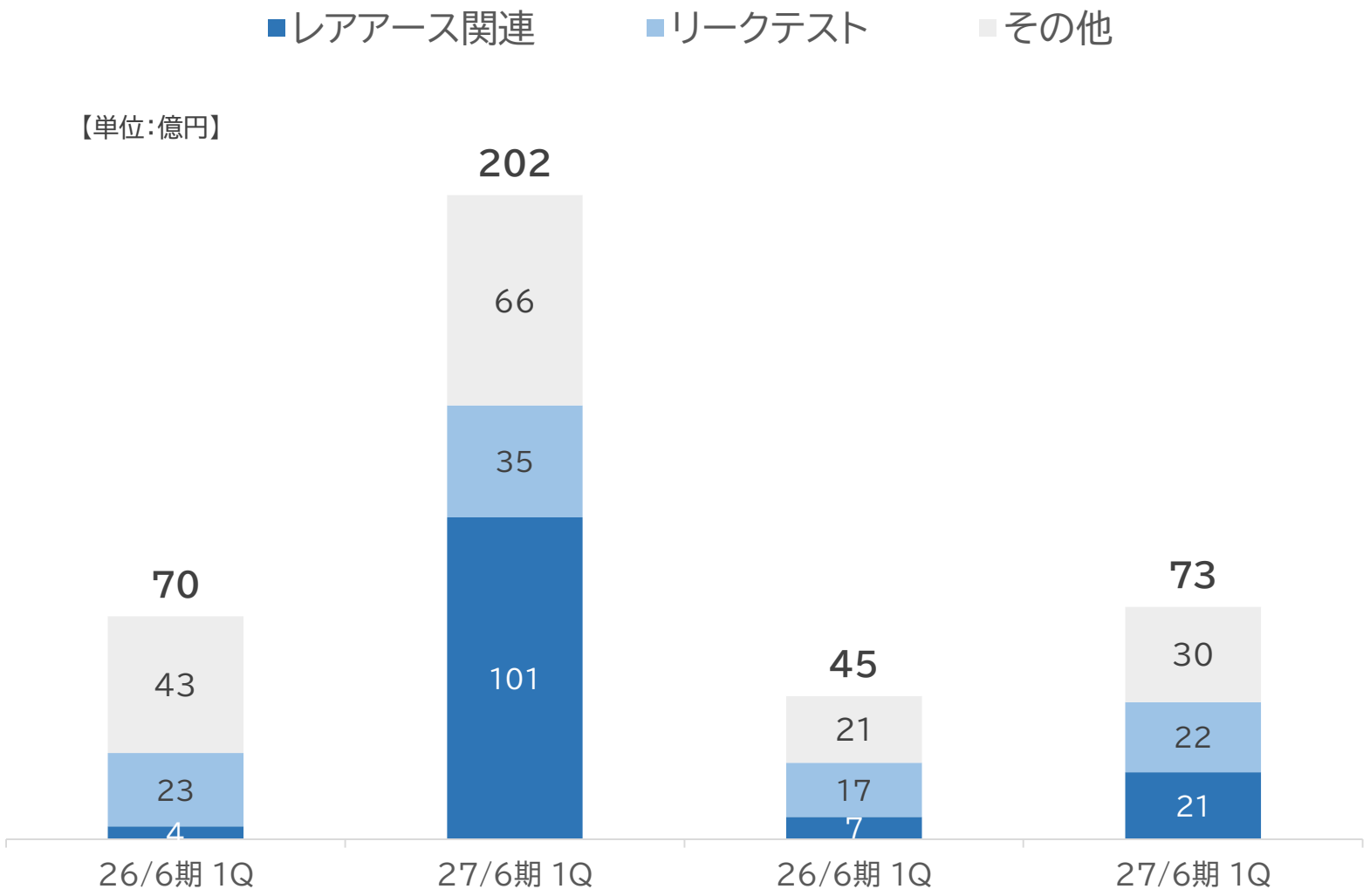
◆ エネルギー関連
フィルムキャパシター向け蒸着装置が堅調に推移

Copyright© 2026, ULVAC, Inc. All rights reserved

一般産業用装置

受注高

売上高

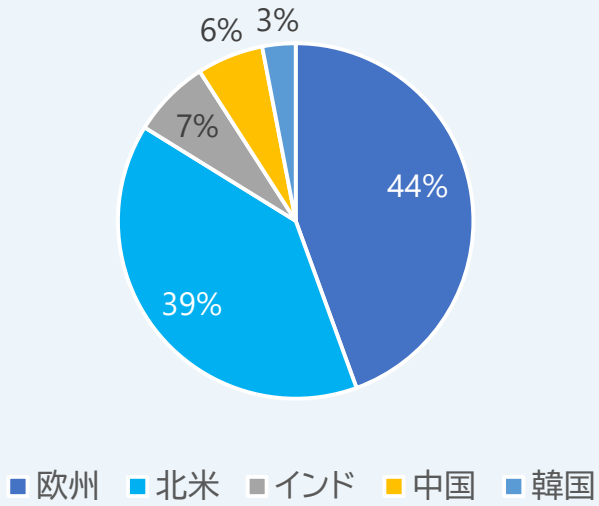


POINT

レアアース関連受注好調

各国のサプライチェーン再構築や政策支援を背景に、欧米からの1Q受注が全体の8割以上を占め、受注を強力に牽引

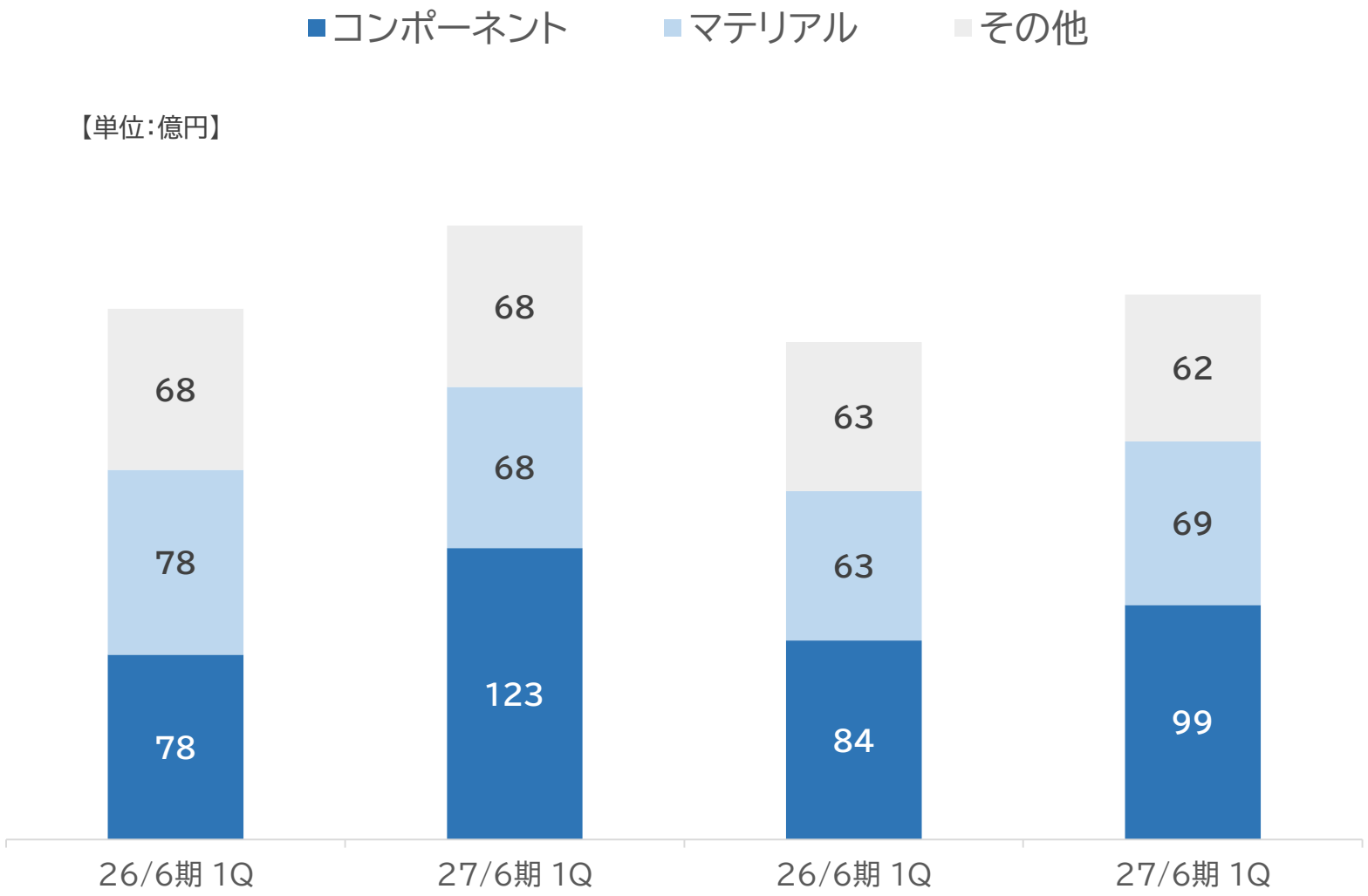
レアアース関連1Q受注高_地域別構成比



Copyright© 2026, ULVAC, Inc. All rights reserved

コンポーネント/マテリアル/その他

受注高　　売上高



POINT

半導体投資活況による事業拡大

◆　コンポーネント
半導体後工程・AIサーバー周辺設備向け
ポンプ・計測器等が好調に推移

◆　マテリアル
半導体(ロジック・メモリ・CMOS等)向け
ターゲット材好調、新たな評価案件拡大中。
一方、ディスプレイ関連事業の売却に伴う
事業規模縮小の影響により前期比減少

◆　その他
表面分析装置等が引き続き堅調に推移

Copyright© 2026, ULVAC, Inc. All rights reserved

3 2027年6月期　業績予想

業績予想

【単位:億円】

	2026/6期 実績	2027/6期 予想 上期 前回予想	2027/6期 予想 上期 今回予想	2027/6期 予想 通期 前回予想	2027/6期 予想 通期 今回予想	前期比	
受注高	3,242	1,300	1,800	2,600	2,900	-342	-11%
売上高	2,691	1,250	1,470	2,550	2,830	+139	+5%
売上総利益	777	415	465	860	910	+133	+17%
率	28.9%	33.2%	31.6%	33.7%	32.2%	+3.3pt	
販管費	581	290	320	580	610	+29	+5%
営業利益	196	125	145	280	300	+104	+53%
率	7.3%	10.0%	9.9%	11.0%	10.6%	+3.3pt	
経常利益	199	125	145	280	300	+101	+51%
率	7.4%	10.0%	9.9%	11.0%	10.6%	+3.2pt	
親会社株主に帰属する当期純利益	171	80	90	190	200	+29	+17%
率	6.4%	6.4%	6.1%	7.5%	7.1%	+0.7pt	
1株あたり配当金(円)	152				152	-	

■上方修正要因

- 第1四半期は、受注・売上・利益ともに前年同期を大きく上回る進捗。バリューアッププランの効果発現や高水準の受注残高により、今後も堅調な事業環境が継続する見通し

Copyright© 2026, ULVAC, Inc. All rights reserved

セグメント/品目 受注高・売上高予想

【単位：億円】

セグメント/品目	受注高				売上高			
	26/6期 実績	27/6期		前期比	26/6期 実績	27/6期		前期比
		前回予想	今回予想			前回予想	今回予想	
半導体及び電子部品製造装置	1,133	1,155	1,155	+22	883	1,070	1,150	+267
ディスプレイ・エネルギー関連製造装置	670	445	560	-110	637	485	520	-117
一般産業用装置	456	340	400	-56	222	280	330	+108
コンポーネント	367	330	370	+3	365	330	370	+5
真空機器事業	2,626	2,270	2,485	-141	2,108	2,165	2,370	+262
マテリアル	323	105	190	-133	279	145	205	-74
その他	293	225	225	-68	305	240	255	-50
真空応用事業	616	330	415	-201	584	385	460	-124
合計	3,242	2,600	2,900	-342	2,691	2,550	2,830	+139

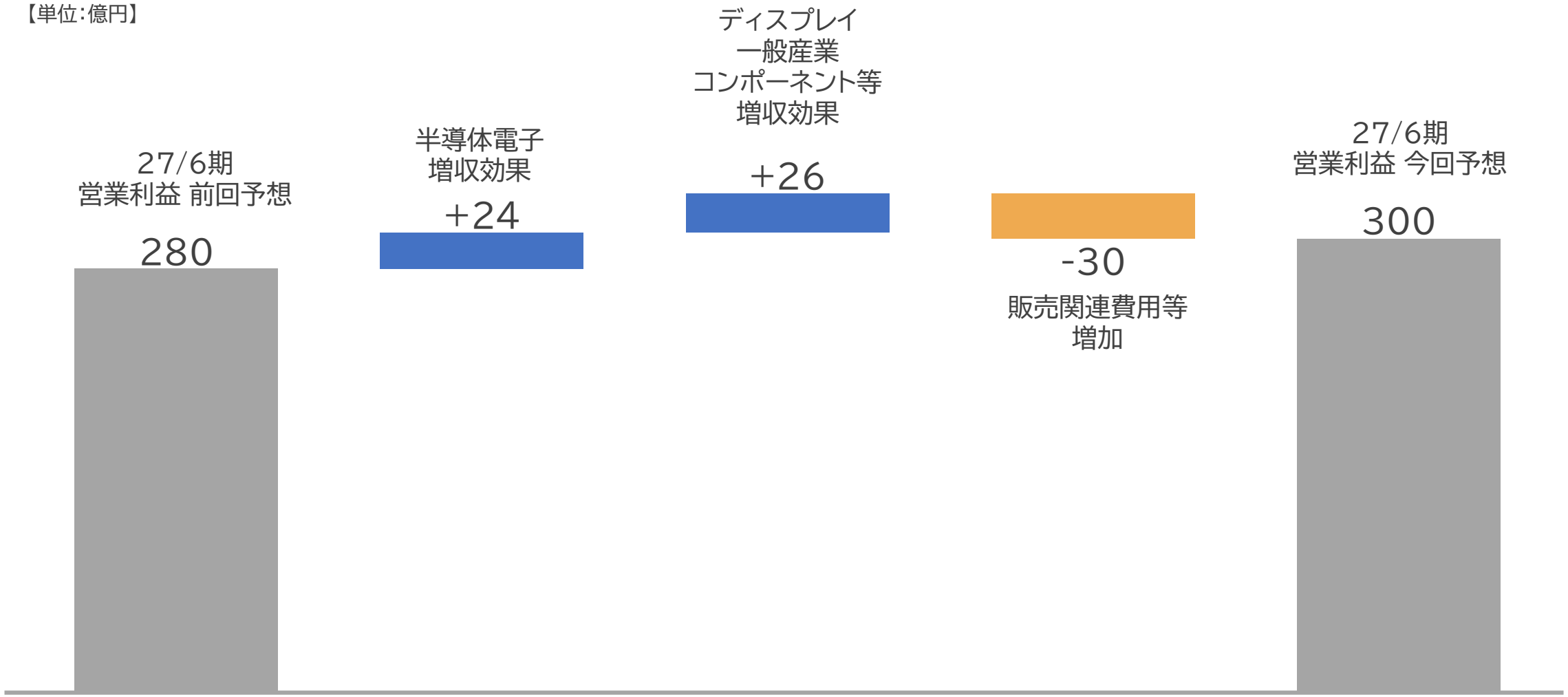
■主な修正点

・各分野での好調な受注推移と、高水準の受注残高の順次寄与

Copyright© 2026, ULVAC, Inc. All rights reserved

営業利益増減分析

【単位：億円】



Copyright© 2026, ULVAC, Inc. All rights reserved

バリューアッププラン進捗：成長戦略

成長戦略 ｜ 付加価値の高い半導体電子・レアアース関連ビジネスが成長

01 半導体・電子デバイス



市場・成長のドライバー

- AI・先端半導体投資を背景とした先端ロジック・メモリ需要の拡大
- 微細化に伴うハードマスク膜＋金属工程膜の適用拡大に伴うソリューション提供
- 先端パッケージング（WLP＋PLP向けソリューション）需要の取り込み

02 レアアース磁石関連ビジネス



市場・成長のドライバー

- 米国を中心としたサプライチェーン再構築（生産回帰）が加速
- 圧倒的シェアを誇る真空溶解炉・連続式焼結炉による積極的な受注獲得
- AI・フィジカルAI・ EVトラクションモーター・風力発電需要の拡大

成長を支える取り組み

中長期的に成長する付加価値の高いビジネスへ事業ポートフォリオをシフトし、
半導体・電子分野を中心とした成長領域へ経営資源を重点的に配分

Copyright© 2026, ULVAC, Inc. All rights reserved

バリューアッププラン進捗：生産改革・事業改革

生産体制の強化と事業ポートフォリオ改革により、持続的な成長と企業価値の向上を目指す

生産改革 ｜ 部材調達・生産体制強化

基本方針

部材供給・生産制約の早期解消に向けて、生産体制全体の抜本的な見直し

アプローチ

部品・材料調達

調達環境のタイト化に対応し、当下期の平準化に向けた対策を実行中

生産体制

工場内スペースの有効活用等によるキャパシティー増強を推進

事業改革 ｜ 事業ポートフォリオの最適化

アルバック成膜㈱
（及び連結子会社：2社、
ｱﾙﾊﾞｯｸ成膜の完全子会社：1社）

全株式譲渡 →

稲畑産業㈱
（合弁相手）

2026年10月27日
取締役会決議

2026年12月18日
株式譲渡実行（予定）

※本件が2027年6月期の連結業績に与える影響は軽微な見込み

事業売却・縮小の取り組み

7 社完了予定
（12月末時点）/ 8社対象

8社対象内訳：事業売却5社（予）、持分譲渡1社（完）、事業撤退1社（完）、統合1社（完）

引き続き、半導体・電子分野を中心とした成長領域へ経営資源を重点的に配分し、更なる企業価値向上を目指す

※残り1社については、当下期中の譲渡完了見込み

Copyright© 2026, ULVAC, Inc. All rights reserved

Appendix

業績(四半期推移)

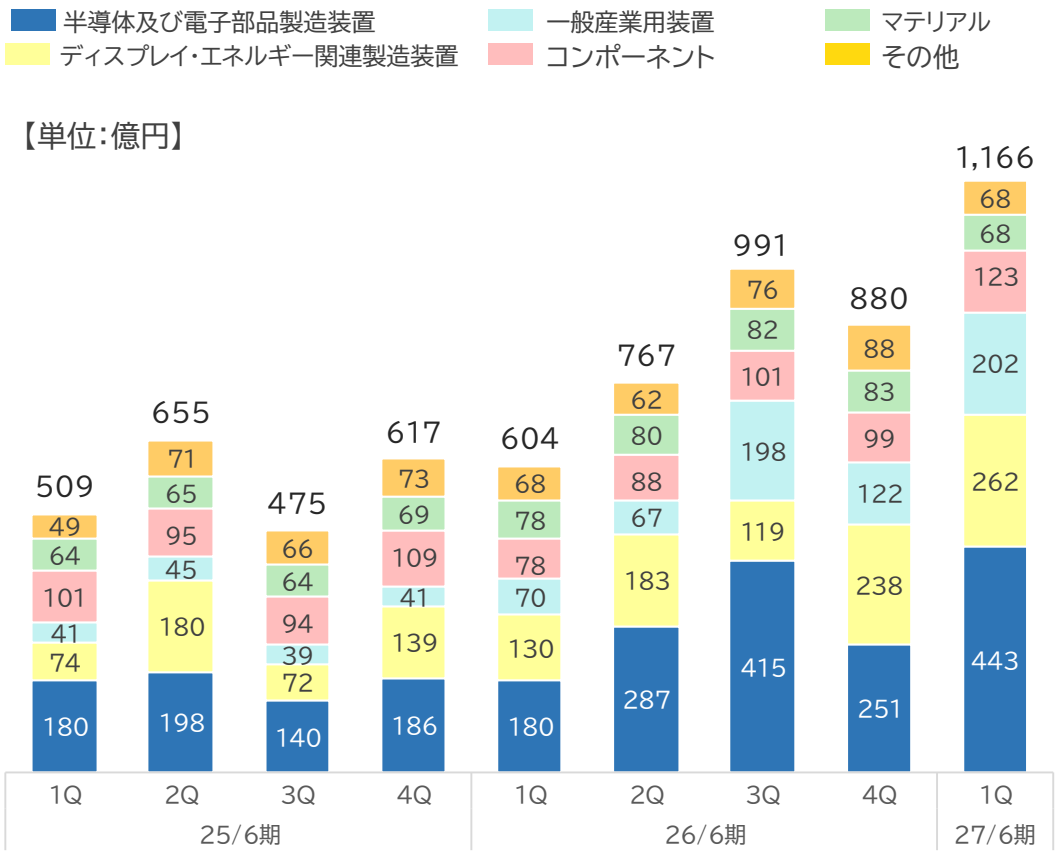
【単位:億円】

	2025/6期				2026/6期				2027/6期
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q
受注高	509	655	475	617	604	767	991	880	1,166
売上高	610	739	529	635	527	712	677	775	733
売上総利益	191	238	176	193	157	207	217	197	214
率	31.3%	32.2%	33.3%	30.5%	29.7%	29.1%	32.0%	25.4%	29.2%
販管費	134	142	122	136	134	145	154	148	152
営業利益	58	96	54	58	23	62	63	49	62
率	9.4%	13.0%	10.2%	9.1%	4.3%	8.7%	9.2%	6.3%	8.4%
経常利益	69	92	61	65	25	67	54	54	90
率	11.3%	12.4%	11.5%	10.2%	4.7%	9.4%	7.9%	6.9%	12.3%
親会社株主に帰属する四半期純利益	37	67	27	36	17	45	29	80	57
率	6.1%	9.0%	5.1%	5.6%	3.2%	6.4%	4.3%	10.3%	7.7%

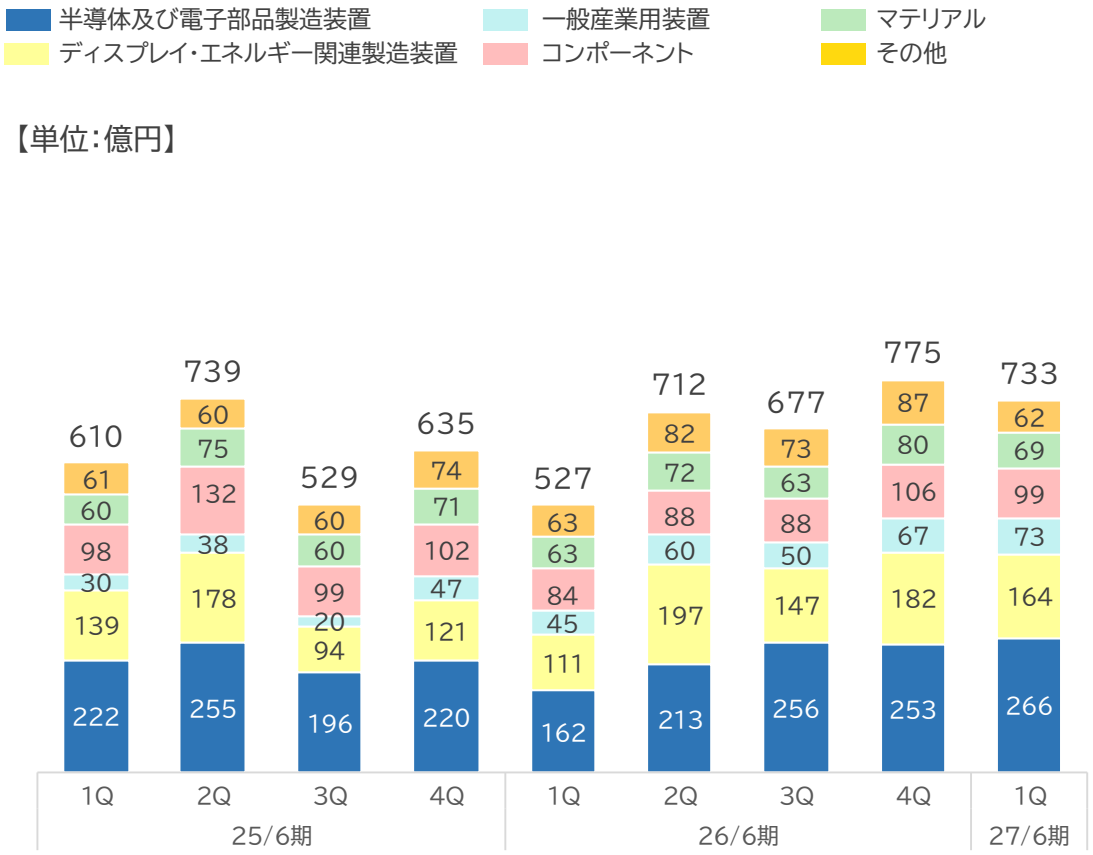
Copyright© 2026, ULVAC, Inc. All rights reserved

受注高・売上高実績（四半期推移）

受注高



売上高

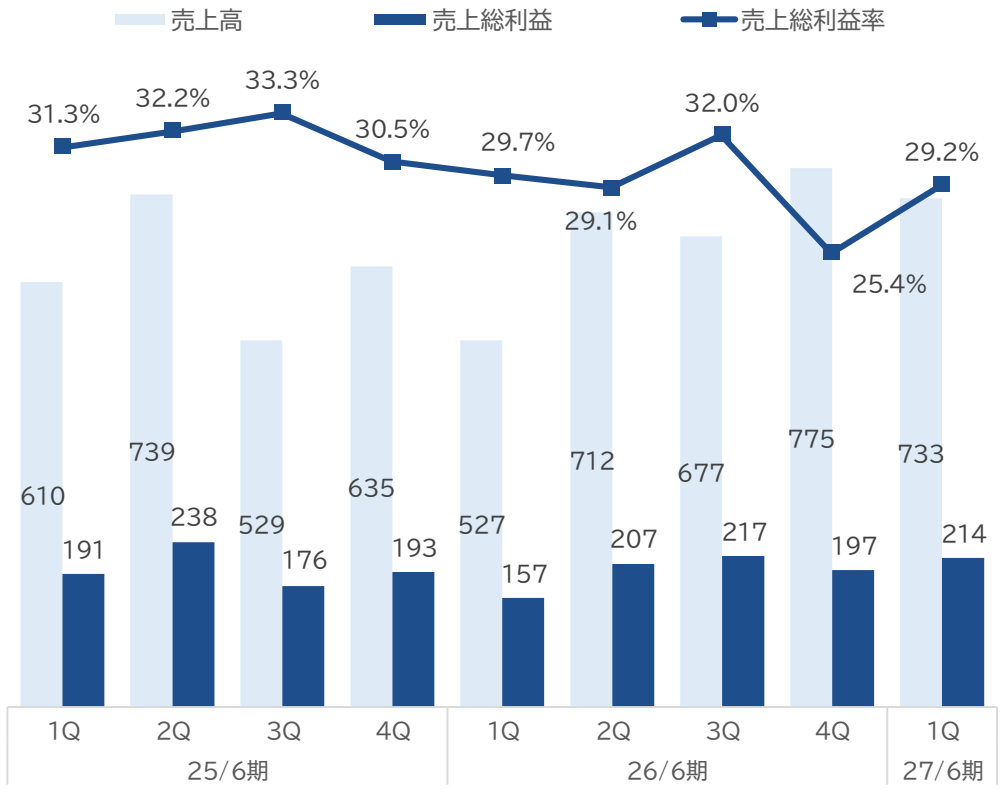


Copyright© 2026, ULVAC, Inc. All rights reserved

利益率実績(四半期推移)

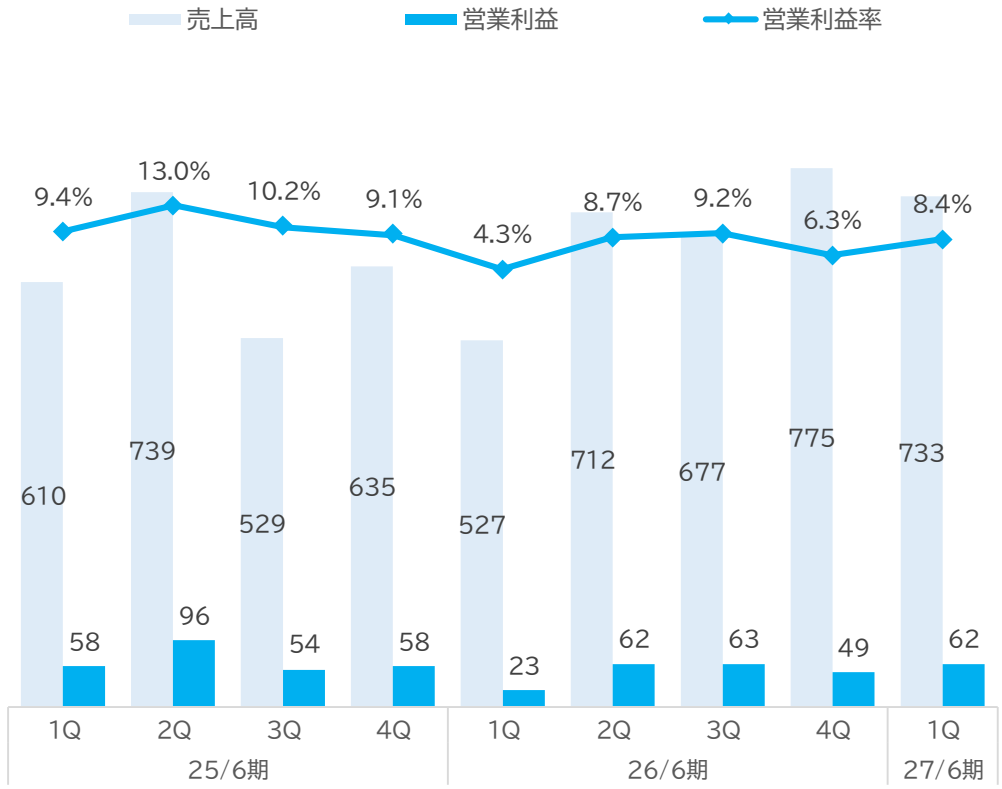
売上総利益率

【単位:億円】



営業利益率

【単位:億円】



Copyright© 2026, ULVAC, Inc. All rights reserved

用語集

- **PVD（Physical Vapor Deposition：物理成膜）**
  薄膜形成をする成膜技術（当社の場合は主にスパッタ）

- **MHM（Metal Hard Mask：メタル・ハード・マスク）**
  配線層形成を目的に、エッチング工程での加工用マスク膜
  （当社はPVD：スパッタ膜）

- **POR（Process of Record）**
  量産に使われる認定プロセス

- **HM（Hard Mask：ハード・マスク）**
  PVD等で成膜されたマスク層

- **FEOL（Front End of Line）**
  トランジスタやキャパシタ、抵抗などをシリコンウェハ上に形成する半導体製造プロセスの初期段階を指す

- **BEOL（Back End of Line）**
  FEOLで形成されたトランジスタなどのデバイスを接続するための配線や金属層を形成する半導体製造プロセスの後半工程を指す

- **RDL（Redistribution Layer：再配線層）**
  半導体チップ上の微細な電極パッドを、より広い間隔の外部接続端子（はんだボールなど）に繋ぎ直すために形成される配線層

- **HBM（High Bandwidth Memory：広帯域幅メモリ）**
  複数のDRAMを垂直に積層し、シリコン貫通電極（TSV）で接続することで、高速・高密度を実現した次世代メモリ技術

- **WLP（Wafer Level Package：ウェーハレベルパッケージ）**
  ウェーハ（半導体基板）の状態でパッケージング工程を行う技術で半導体パッケージング技術の一つ

- **PLP（Panel Level Package：パネルレベルパッケージ）**
  従来のウェハレベルパッケージ（WLP）に代わり、四角いパネル状の基板を用いてパッケージングを行う半導体パッケージング技術の一つ
  パネルに多数の半導体チップを基板全体に配置して一括してパッケージングする技術

Copyright© 2026, ULVAC, Inc. All rights reserved

技術屋は、
世界が変わる
場所にいる。

ULVAC